

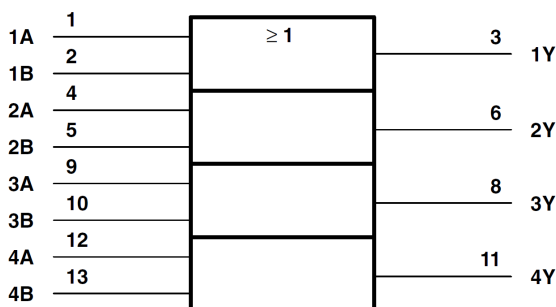
SN74AHCT32-Q1 汽车类四路 2 输入正或门

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准：
 - 器件温度等级 1：-40°C 至 +125°C
 - 器件 HBM ESD 分类等级 2
 - 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQA) 封装
- 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 低功耗， I_{CC} 最大值为 10μA
- 5V 时，输出驱动为 ±8mA
- 输入兼容 TTL 电压

2 应用

- 启用或禁用数字信号
- 控制指示灯 LED
- 通信模块和系统控制器之间的转换



逻辑符号

3 说明

SN74AHCT32 是四通道 2 输入正或门。该器件以正逻辑执行布尔函数 $Y = A \times B$ 或 $Y = A + B$ 。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾	封装尺寸 ⁽³⁾
SN74AHCT32-Q1	D (SOIC, 14)	8.7mm × 6mm	8.7mm × 3.9mm
	PW (TSSOP, 14)	5mm × 6.4mm	5mm × 4.4mm
	BQA (WQFN, 14)	3mm × 2.5mm	3mm × 2.5mm

- 更多信息，请参阅第 11 节。
- 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。
- 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，不包括引脚。



¹ † 符号符合 ANSI/IEEE 标准 91-1984 和 IEC 出版物 617-12



内容

1 特性.....	1	7.1 概述.....	8
2 应用.....	1	7.2 功能方框图.....	8
3 说明.....	1	7.3 器件功能模式.....	8
4 引脚配置和功能.....	3	8 应用和实施.....	9
5 规格.....	4	8.1 应用信息.....	9
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.2 典型应用.....	9
5.2 ESD 等级.....	4	8.3 电源相关建议.....	11
5.3 建议运行条件.....	4	8.4 布局.....	11
5.4 热性能信息.....	4	9 器件和文档支持.....	13
5.5 电气特性.....	5	9.1 接收文档更新通知.....	13
5.6 开关特性.....	5	9.2 支持资源.....	13
5.7 噪声特性.....	5	9.3 商标.....	13
5.8 工作特性.....	5	9.4 静电放电警告.....	13
5.9 典型特性.....	6	9.5 术语表.....	13
6 参数测量信息.....	7	10 修订历史记录.....	13
7 详细说明.....	8	11 机械、封装和可订购信息.....	13

4 引脚配置和功能

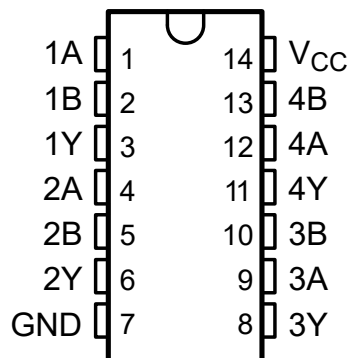


图 4-1. D 或 PW 封装，14 引脚 SOIC 或 TSSOP (顶视图)

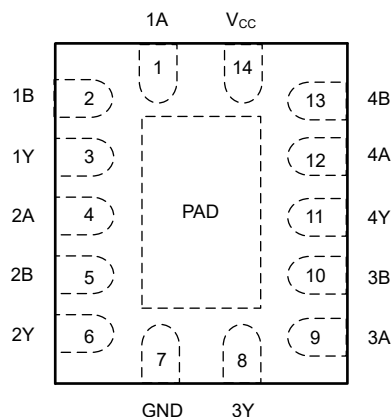


图 4-2. BQA (预发布) 封装，14 引脚 WQFN (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
1A	1	I	1A 输入
1B	2	I	1B 输入
1Y	3	O	1Y 输出
2A	4	I	2A 输入
2B	5	I	2B 输入
2Y	6	O	2Y 输出
GND	7	—	接地引脚
3Y	8	O	3Y 输出
3A	9	I	3A 输入
3B	10	I	3B 输入
4Y	11	O	4Y 输出
4A	12	I	4A 输入
4B	13	I	4B 输入
V _{CC}	14	I	电源引脚
散热焊盘 ⁽²⁾		—	散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。

(1) I = 输入，O = 输出

(2) 仅限 BQA 封装

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围	-0.5	7	V
V_I	输入电压范围 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V_O	输出电压范围 ⁽²⁾	-0.5	$V_{CC}+0.5$	V
I_{IK}	输入钳位电流	$(V_I < 0)$		-20 mA
I_{OK}	输出钳位电流	$(V_O < 0 \text{ 或 } V_O > V_{CC})$		±20 mA
I_O	持续输出电流	$(V_O = 0 \text{ 至 } V_{CC})$		±25 mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流			±50 mA
T_{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在 *建议运行条件* 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议工作条件但在绝对最大额定值范围内使用, 器件可能不会完全正常运行, 这可能影响器件的可靠性、功能和性能, 并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值, 输入和输出电压可超过额定值。

5.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$ 静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾	±2000	V
	充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011 标准	±100	

- (1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	4.5	5.5	V
I_H	高电平输入电压	2		V
V_{IL}	低电平输入电压		0.8	V
V_I	输入电压	0	5.5	V
V_O	输出电压	0	V_{CC}	V
I_{OH}	高电平输出电流		-8	mA
I_{OL}	低电平输出电流		8	mA
$\Delta t/\Delta v$	输入转换上升或下降速率		20	ns/V
T_A	自然通风工作温度	-40	125	°C

- (1) 器件所有的未使用输入必须被保持在 V_{CC} 或 GND 以确保器件正常运行。请参阅 TI 应用报告, [CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响](#)。

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		SN74AHCT32-Q1			单位
		D	PW	BQA	
		14PINS	14PINS	14 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	124.6	147.7	88.3	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用报告。

5.5 电气特性

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围 (除非另外注明)

参数	测试条件	V _{CC}	T _A = 25°C			最小值	最大值	单位
			最小值	典型值	最大值			
V _{OH}	I _{OH} = -50μA	4.5V	4.4	4.5		4.4		V
	I _{OH} = -8mA		3.94			3.8		
V _{OL}	I _{OL} = 50μA	4.5V			0.1		0.1	V
	I _{OL} = 8mA				0.36		0.44	
I _I	V _I =5.5V 或 GND	0V 至 5.5V			±0.1		±1	μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} 或 GND, I _O = 0	5.5V			2		20	μA
Δ I _{CC} ⁽¹⁾	一个输入电压为 3.4V, 其他输入电压为 V _{CC} 或 GND	5.5V			1.35		1.5	mA
C _i	V _I =V _{CC} 或 GND	5V		2	10			pF

(1) 这是每个输入在指定 TTL 电压电平之一而不是 0V 或 V_{CC} 时电源电流的增加情况。

5.6 开关特性

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得, V_{CC} = 5V ± 0.5V (除非另有说明) (请参阅 [负载电路和电压波形](#))

参数	从 (输入)	到 (输出)	负载 电容	T _A = 25°C			最小值	最大值	单位
				最小值	典型值	最大值			
t _{PLH}	A 或 B	Y	C _L = 15 pF		5	6.9	1	8	ns
t _{PHL}					5	6.9	1	8	
t _{PLH}	A 或 B	Y	C _L = 50pF		5.5	7.9	1	9	ns
t _{PHL}					5.5	7.9	1	9	

5.7 噪声特性

V_{CC} = 5V, C_L = 50pF, T_A = 25°C⁽¹⁾

参数		SN74AHCT32-Q1			单位
		最小值	典型值	最大值	
V _{OL(P)}	安静输出, 最大动态 V _{OL}		0.4	0.8	V
V _{OL(V)}	安静输出, 最小动态 V _{OL}		- 0.4	-0.8	V
V _{OH(V)}	安静输出, 最小动态 V _{OH}		4.5		V
V _{IH(D)}	高电平动态输入电压	2			V
V _{IL(D)}	低电平动态输入电压			0.8	V

(1) 特性仅适用于表面贴装封装。

5.8 工作特性

V_{CC} = 5V, T_A = 25°C

参数	测试条件	典型值	单位
C _{pd}	功率耗散电容 无负载, f = 1MHz	11.5	pF

5.9 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

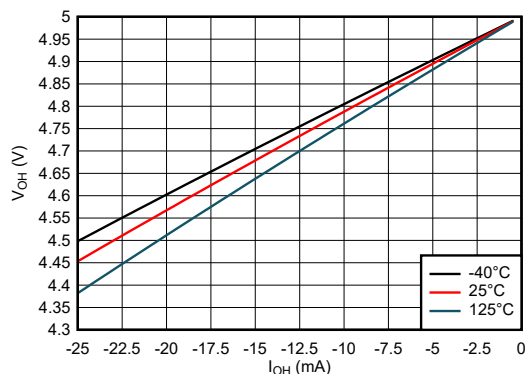


图 5-1. 高电平状态下输出电压与电流间的关系；5V 电源

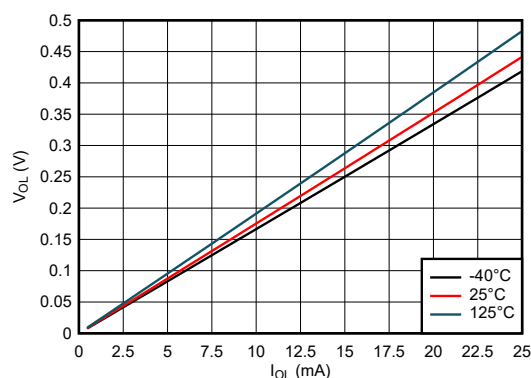
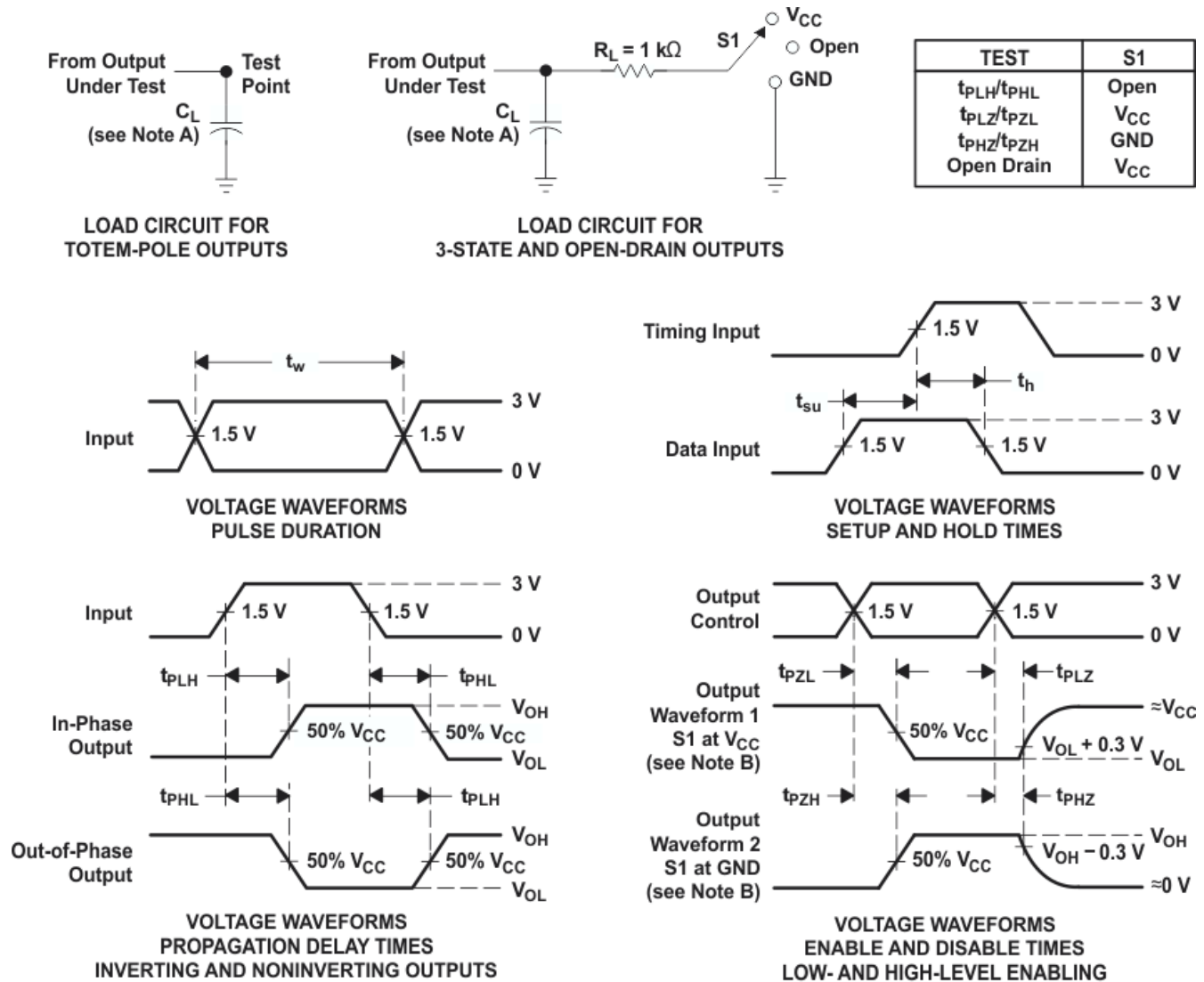


图 5-2. 低电平状态下输出电压与电流间的关系；5V 电源

6 参数测量信息



- NOTES: A. C_L includes probe and jig capacitance.
 B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high except when disabled by the output control.
 C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR $\leq 1\text{ MHz}$, $Z_O = 50\ \Omega$, $t_r \leq 3\text{ ns}$, $t_f \leq 3\text{ ns}$.
 D. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
 E. All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

图 6-1. 负载电路和电压波形

7 详细说明

7.1 概述

SN74AHCT32-Q1 是一款具有低驱动的四路双输入正或门，可产生较慢的上升和下降时间。这种缓慢转换可减少输出信号上的振铃。该器件具有 TTL 输入，可实现从 3.3V 到 5V 的升压转换。当 $V_{CC} = 0V$ 时，输入为高阻抗。

7.2 功能方框图



7.3 器件功能模式

表 7-1. 功能表
(每个逻辑门)

输入		输出 Y
A	B	
H	X	H
X	H	H
L	L	L

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规范，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定各元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计实现，以确认系统功能。

8.1 应用信息

在该应用中，将三个双输入或门相组合，可实现 4 输入或门的功能，如**典型应用方框图**所示。第四个门可用于系统中的另一个应用，或者可将输入接地，不使用该通道。

SN74AHCT32-Q1 用于直接控制风扇驱动器的使能引脚。要启用风扇驱动器，仅需一个输入信号处于高电平即可，并且在所有信号变为低电平时应禁用风扇驱动器。4 输入或门功能将四个单独的过热信号组合成一个高电平有效使能信号。

温度传感器通常会分布在整个系统中，并非集中在同一位置。这样一来，需要更长的布线或导线来传递信号，会导致边沿转换变慢。这使得 **SN74AHCT32-Q1** 对于组合传入信号非常有用。

8.2 典型应用

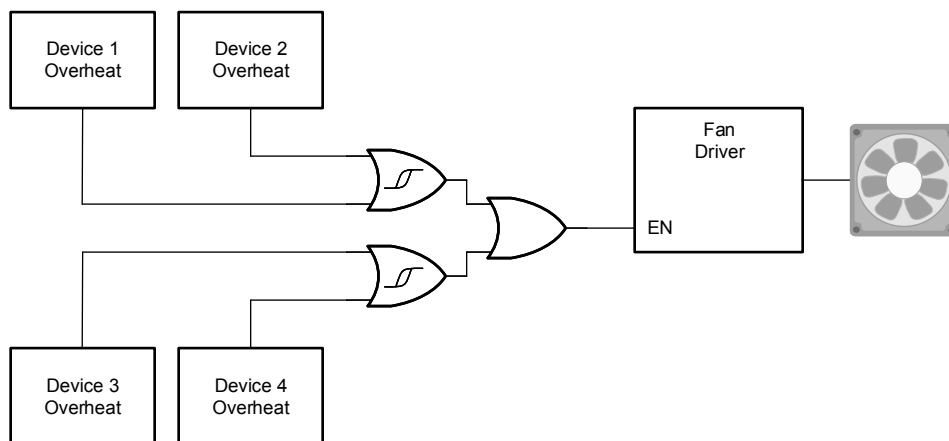


图 8-1. 典型应用框图

8.2.1 设计要求

8.2.1.1 电源注意事项

确保所需电源电压在**建议的工作条件**中规定的范围内。电源电压按照**电气特性**部分中所述设置器件的电气特性。

正电压电源必须能够提供的电流等于 最大静态电源电流 I_{CC} (在**电气特性**中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。

地必须能够灌入的电流等于 SN74AHCT32-Q1 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

SN74AHCT32-Q1 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载, 同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载; 但建议不要超过 50pF。

SN74AHCT32-Q1 可以驱动由 $R_L \geq V_O/I_O$ 描述的总电阻负载, 输出电压和电流在 *电气特性* 表中用 V_{OL} 定义。在高电平状态下输出时, 公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 V_{CC} 引脚处的电源电压之间的差值。

总功耗可以使用 *CMOS 功耗与 Cpd 计算* 应用手册中提供的信息进行计算。

可以使用 *标准线性逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性* 应用手册中提供的信息计算热增量。

小心

绝对最大额定值 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 *绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过 才能被视为逻辑低电平, 超过 才能被视为逻辑高电平。不要超过 *绝对最大额定值* 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用, 则可以直接端接未使用的输入, 如果有时要使用输入, 但并非始终使用, 则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态, 下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 SN74AHCT32-Q1 的漏电流 (如 *电气特性* 中所规定) 以及所需输入转换率会限制电阻大小。由于这些因素, 通常使用 10k Ω 的电阻值。

有关此器件的输入的附加信息, 请参阅 *特性描述* 部分。

8.2.1.3 输出注意事项

接地电压用于产生输出低电平电压。根据 *电气特性* 中 V_{OL} 规范的规定, 向输出端灌入电流将提高输出电压。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或地。

有关此器件的输出的附加信息, 请参阅 *特性描述* 部分。

8.2.2 详细设计过程

1. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。布局部分中展示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载 $\leq 50\text{pF}$ 。这不是硬性限制；但是，根据设计，该限制将优化性能。这可以通过从 SN74AHCT32-Q1 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于 $(V_{CC}/I_{O(max)}) \Omega$ 。这可防止超出绝对最大额定值中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 $M\Omega$ 为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题；然而，可以使用应用报告 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的步骤计算功耗和热增量。

8.2.2.1 应用曲线

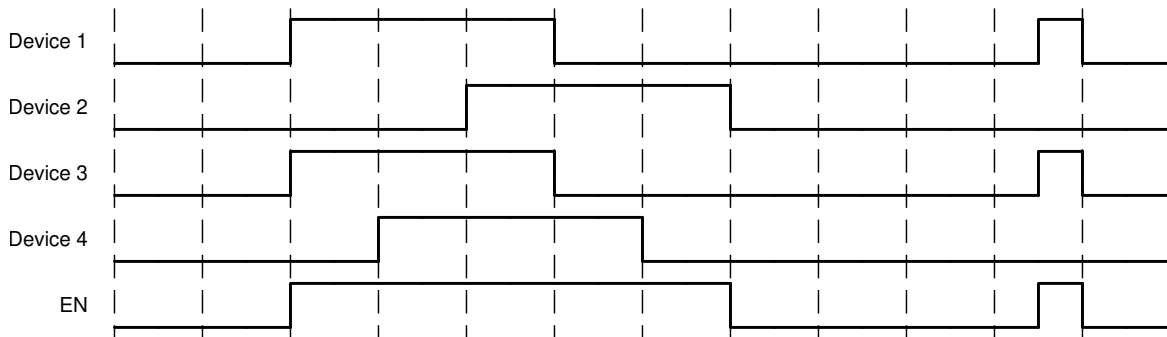


图 8-2. 应用时序图

8.3 电源相关建议

电源可以是 [节 5.3](#) 中最小和最大电源电压额定值之间的任意电压。

电源可以是 *建议的工作条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子均应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用 $0.1 \mu\text{F}$ 电容。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1 \mu\text{F}$ 和 $1 \mu\text{F}$ 电容器通常并联使用。旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置，以获得更佳效果，如 *布局示例* 所示。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，未使用数字逻辑器件的功能或部分功能（例如，当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时）。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到 GND 或 V_{CC} ，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

8.4.1.1 布局示例

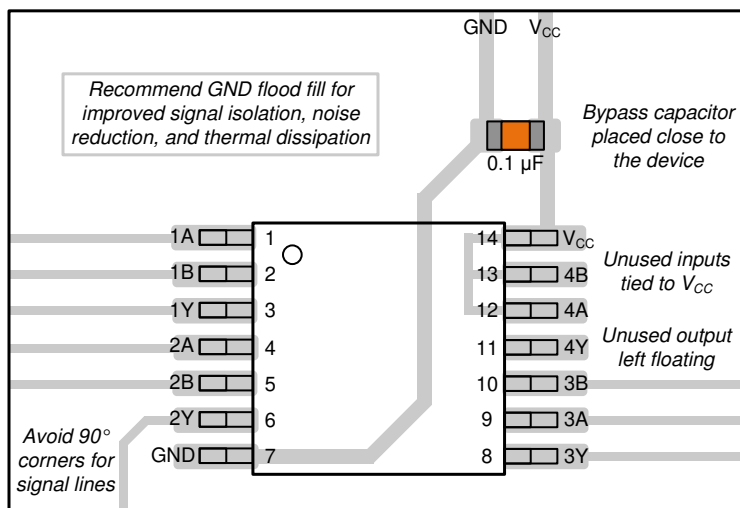


图 8-3. SN74AHCT32-Q1 的示例布局

9 器件和文档支持

9.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.2 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

9.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.5 术语表

TI 术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision C (July 2023) to Revision D (February 2024)	Page
• 更新了 R _{θJA} 值：D = 86 至 124.6，所有值均以 °C/W 为单位.....	4

Changes from Revision B (May 2023) to Revision C (July 2023)	Page
• 将 PW 封装的热性能值从 R _{θJA} = 113 更新为 147.7，所有值均以 °C/W 为单位.....	4

11 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74AHCT32QDRG4Q1	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT32Q
SN74AHCT32QDRG4Q1.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT32Q
SN74AHCT32QDRQ1	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT32Q
SN74AHCT32QDRQ1.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT32Q
SN74AHCT32QPWRG4Q1	NRND	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT32Q
SN74AHCT32QPWRG4Q1.A	NRND	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT32Q
SN74AHCT32QPWRQ1	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(AHCT32Q, HB32Q)
SN74AHCT32QPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(AHCT32Q, HB32Q)
SN74AHCT32QWBQARQ1	Active	Production	WQFN (BQA) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHT32Q
SN74AHCT32QWBQARQ1.A	Active	Production	WQFN (BQA) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHT32Q

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AHCT32-Q1 :

- Catalog : [SN74AHCT32](#)
- Enhanced Product : [SN74AHCT32-EP](#)
- Military : [SN54AHCT32](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74AHCT32QDRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74AHCT32QPWRG4Q1	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AHCT32QPWRQ1	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AHCT32QPWRQ1	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AHCT32QWBQARQ1	WQFN	BQA	14	3000	180.0	12.4	2.8	3.3	1.1	4.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74AHCT32QDRQ1	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
SN74AHCT32QPWRG4Q1	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
SN74AHCT32QPWRQ1	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
SN74AHCT32QPWRQ1	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
SN74AHCT32QWBQARQ1	WQFN	BQA	14	3000	210.0	185.0	35.0

D0014A**PACKAGE OUTLINE****SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4220718/A 09/2016

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

BQA 14

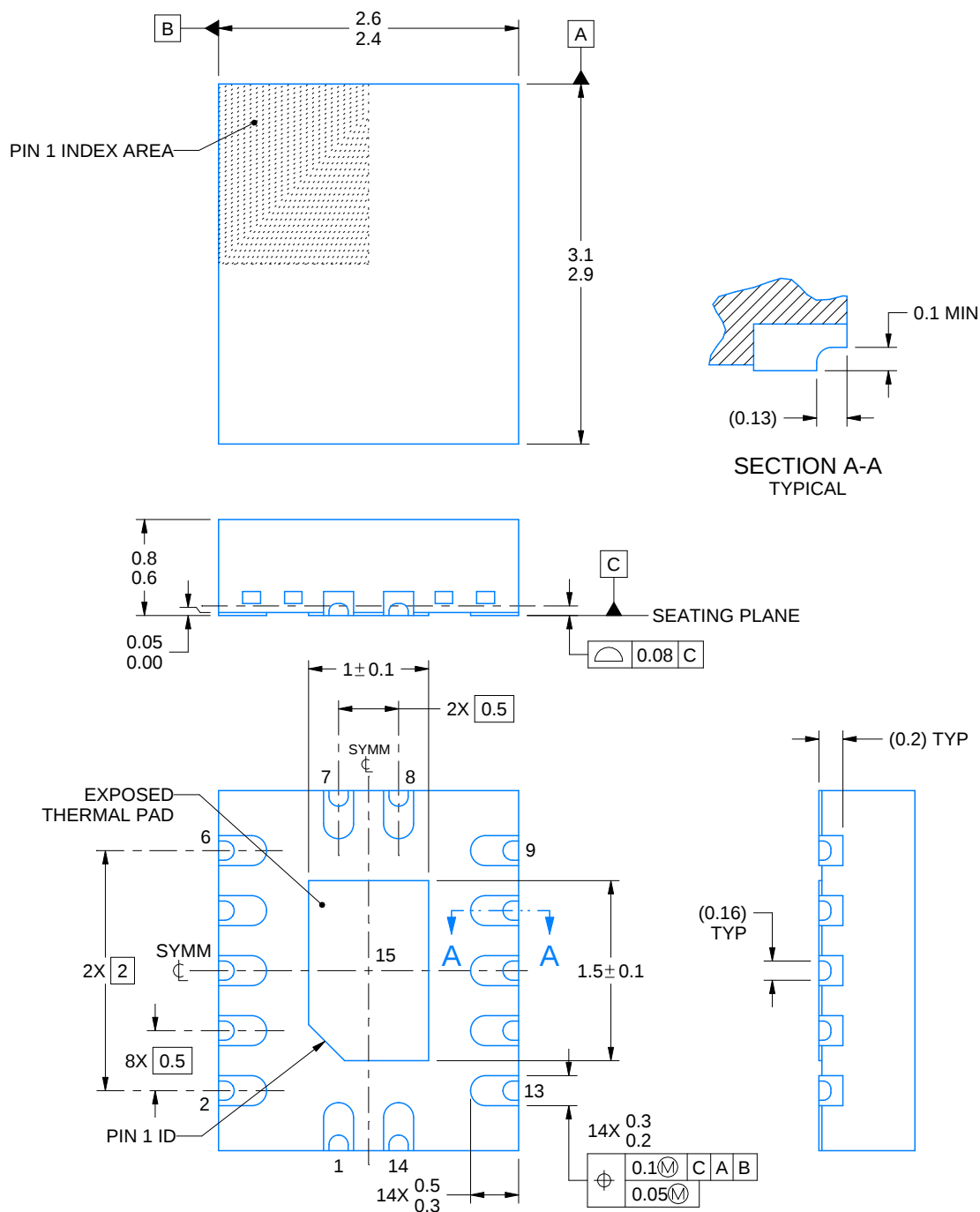
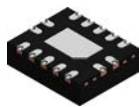
WQFN - 0.8 mm max height

2.5 x 3, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.





4227062/B 09/2021

NOTES:

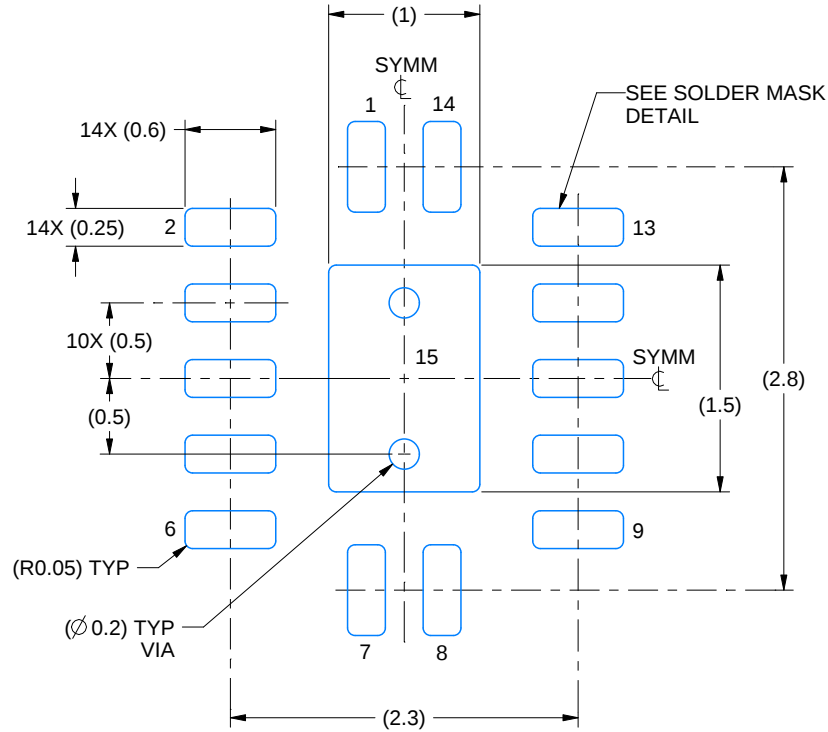
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

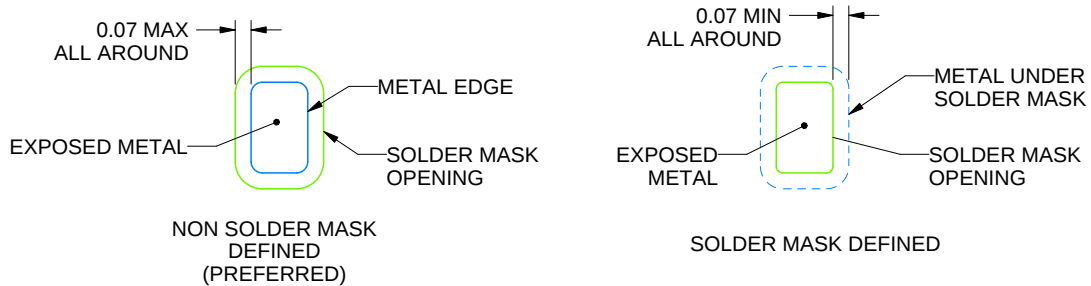
BQA0014B

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



SOLDER MASK DETAILS

4227062/B 09/2021

NOTES: (continued)

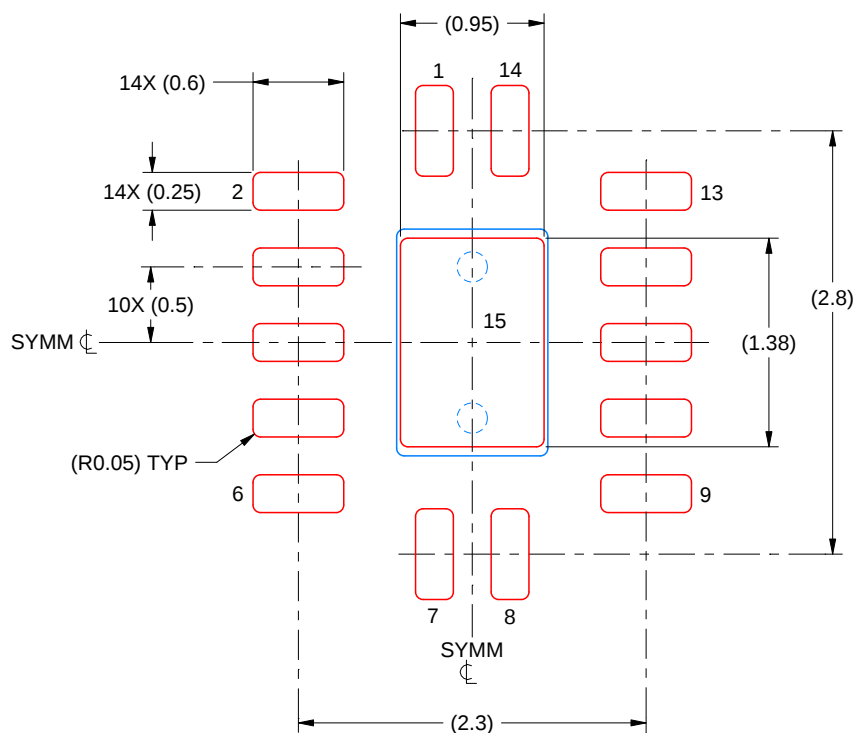
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

BQA0014B

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



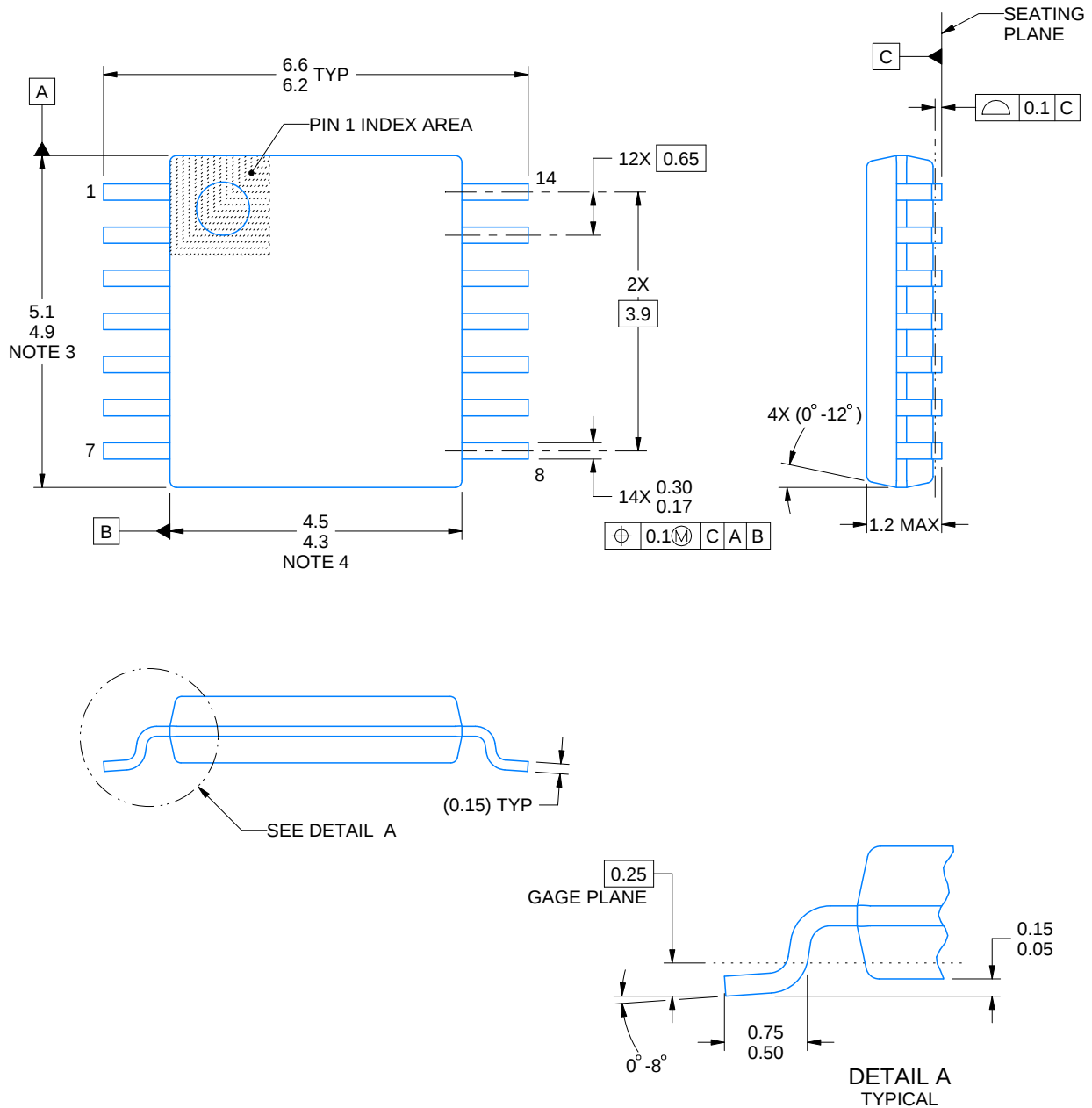
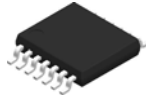
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 20X

EXPOSED PAD 15
87% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4227062/B 09/2021

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.



4220202/B 12/2023

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月